

2020-2026年中国键合金丝 市场评估与投资可行性报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国键合金丝市场评估与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/171772.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

键合金丝是集成电路中用作连接线的金合金丝，又称球焊金丝或引线金丝。

中企顾问网发布的《2020-2026年中国键合金丝市场评估与投资可行性报告》共九章。首先介绍了键合金丝相关概念及发展环境，接着分析了中国键合金丝规模及消费需求，然后对中国键合金丝市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国键合金丝面临的机遇及发展前景。您若想对中国键合金丝有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 微电子封装技术与产业状况

第一节 微电子封装及其功能

第二节 IC封装产品与技术发展

一、从IC封装产品发展顺序看封装的技术进步

二、当前主流的封装产品与技术

三、IC封装产品品种的发展趋势

第三节 世界IC封装产业状况

一、世界IC封装产业总体现状

二、世界主要IC封装测试厂商

三、世界IC产业发展趋势

四、国内IC封装产业状况

第二章 键合丝的产品综述

第一节 键合丝的品种及其特性

一、键合金丝

二、键合铝丝

三、键合铜丝

四、各种键合丝特性的对比

第二节引线键合技术

一、热压键合法

二、超声键合法

三、热超声键合法

四、引线键合的两种基本形式

第三节键合丝主要常用标准

第四节键合丝材料主要涉及专利、标准

一、涉及专利

二、主要行业标准

第三章世界键合丝产业现状与市场需求分析

第一节世界键合丝行业现状及市场规模预测

第二节世界键合金丝的主要生产企业情况

第四章我国键合金丝行业发展综述

第一节我国键合金行业发展现状

一、市场需求增幅较大

二、行业利润空间缩小，恶性竞争普遍存在

三、企业面临新的挑战 and 重组势在必行

四、欧盟RoSH法令实施的影响分析

五、外资企业加快进入中国市场，国内企业两极分化严重

六、行业向规模化、无铅环保化方向发展

第二节主要地区分析

一、长三角地区

二、山东省

三、其它地区

第三节应用领域需求分析

一、发光二极管

二、三极管

三、低端IC（DIP、SOP等）

第五章我国键合金丝市场总体概况

- 第一节我国钎合金丝生产情况分析
 - 一、我国钎合金丝生产总体概况分析
 - 二、我国钎合金丝在建拟建项目分析
 - 三、我国钎合金丝未来生产情况预测分析
- 第二节我国钎合金丝原材料供应状况分析
 - 一、主要原材料
 - 二、主要原材料历史价格及供应情况
 - 三、主要原材料当前价格及供应情况
 - 四、主要原材料未来价格及供应情况预测

第六章我国钎合金丝竞争格局分析

- 第一节市场竞争现状分析
- 第二节企业市场占有率分析
- 第三节市场供给现状
- 第四节我国钎合金丝市场竞争格局分析
 - 一市场整体格局分析
 - 二市场竞争格局走势分析

第七章主要生产企业

- 第一节、全球三大企业分析
 - 一、田中贵金属工业株式会社
 - 二、贺利氏控股集团
 - 三、住友金属矿山株式会社
- 第二节、国内主要企业分析
 - 一、贺利氏招远贵金属材料有限公司
 - 二、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司
 - 三、杭州菱庆高新材料有限公司
 - 四、杭州日茂新材料有限公司
 - 五、宁波康强电子股份有限公司
 - 六、北京达博有色金属焊料有限责任公司
 - 七、烟台招金励福贵金属有限公司
 - 八、贵研铂业股份有限公司

第八章我国键合金丝产业发展中存在的问题及行业发展趋势

第一节我国键合金丝产业发展中存在的问题

一、原材料成本方面

二、研发方面

第二节我国键合金丝行业发展趋势分析

一、键合金丝总体发展趋势

二、键合金丝产业及技术发展趋势

第九章行业投资机会与风险分析（）

第一节投资机会分析

第二节投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、进入退出风险

图表目录：

图表1 封装的功能

图表2 全球十大专业封装厂商

图表3 2014年度我国半导体封装测试行业销售额前十名企业

图表4 不同键合丝电阻率对比

图表5 金属间化合物生长规律

图表6 不同键合丝机械性能对比

图表7 各种键合丝特征对比

图表8 各种键合丝优缺点对比

图表9 2016-2019年我国长三角地区键合金丝生产分析

图表10 2016-2019年我国山东地区键合金丝生产分析

图表11 2016-2019年我国其它地区键合金丝生产分析

图表12 2016-2019年我国集成电路行业增长情况

图表13 2019年集成电路出口分季度增长情况

图表14 2019年集成电路行业投资按月增长情况

- 图表15 2016-2019年我国集成电路产业投资情况
- 图表16 2016-2019年我国键合金丝生产量分析
- 图表17 超细OCC铜键合金丝生产建设项目
- 图表18 2020-2026年我国键合金丝未来生产情况预测分析
- 图表19 2019年主要货币计价的黄金价格走势
- 图表20 2016-2019年我国键合金丝生市场供给量分析
- 图表21 近4年田中贵金属工业株式会社总资产周转次数变化情况
- 图表22 近4年田中贵金属工业株式会社资产负债率变化情况
- 图表23 近4年田中贵金属工业株式会社销售毛利率变化情况
- 图表24 近4年田中贵金属工业株式会社固定资产周转次数情况
- 图表25 近4年田中贵金属工业株式会社流动资产周转次数变化情况
- 图表26 近4年田中贵金属工业株式会社产权比率变化情况
- 图表27 近4年田中贵金属工业株式会社已获利息倍数变化情况
- 图表28 近4年贺利氏控股集团总资产周转次数变化情况
- 图表29 近4年贺利氏控股集团资产负债率变化情况
- 图表30 近4年贺利氏控股集团销售毛利率变化情况

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/171772.html>